



2014年1月28日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテスト
代表者名 代 表 取 締 役
兼執行役員社長 松野 晴夫
(コード番号 6857 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員
管 理 本 部 長 中村 弘志
T E L 03-3214-7500

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2014年1月28日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である日本エンジニアリング株式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は100%子会社の吸収合併であるため開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

被合併会社である日本エンジニアリング株式会社は、当社の100%出資の連結子会社であり、当社の半導体・部品テストシステム事業の製品であるバーンイン・システムの開発・製造・販売を行ってまいりましたが、同社のバーンイン・システムノウハウと当社のテスト・システムノウハウを統合し一元化し、テスト工程全体から見た最適なソリューションを顧客に提供しビジネスの拡大を図ることを目的に、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2014年1月28日（火）
合併契約締結	2014年1月28日（火）
合併承認株主総会	本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、日本エンジニアリング株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、合併契約承認株主総会を開催いたしません。
合併期日（効力発生日）	2014年4月1日（火）（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本エンジニアリング株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、日本エンジニアリング株式会社の全株式を所有しており、合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

日本エンジニアリング株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要 (2013年3月31日現在)

(1) 名 称	株式会社アドバンテスト (存続会社)	日本エンジニアリング 株式会社 (消滅会社)
(2) 所 在 地	東京都練馬区旭町 1丁目32番1号	神奈川県川崎市多摩区生田二 丁目9番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役兼執行役員社長 松野 晴夫	代表取締役社長 菅江 均
(4) 事 業 内 容	半導体・部品テストシステム 等の開発、製造、販売および 保守	半導体・部品テストシステム の開発・製造・販売
(5) 資 本 金	32,363百万円	305百万円
(6) 設 立 年 月 日	1954年12月16日	1974年2月13日
(7) 発 行 済 株 式 数	199,566,770株	754,530株
(8) 決 算 期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	(株)アドバンテスト 12.91% 日本マスタートラスト信託銀行 (株)(信託口) 12.57% みずほ信託銀行(株) 退職給付信託 富士通口 再信託受託者 資産管理 サービス信託銀行(株) 10.09% 日本トラスティ・サービス信託銀 行(株)(信託口) 6.65%	(株)アドバンテスト 100%
(10) 直近事業年度の経営成績 および財政状態		
決 算 期	2013年3月期 (連結)	2013年3月期 (個別)
純 資 産	141,241百万円	245百万円
総 資 産	225,515百万円	1,043百万円
1株当たり純資産	812.70円	325.27円
売 上 高	132,903百万円	1,568百万円
営 業 利 益	80百万円	△176百万円
税引前当期純利益	△1,293百万円	△92百万円
当 期 純 利 益	△3,821百万円	△99百万円
1株当たり当期純利益	△22.03円	△131.64円

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響はありません。

以 上